**半自动轮转式切片机技术参数**

1.切片方式:半自动轮转

2.切片厚度:0.5-100微米

3.修片厚度：1-600微米

4.水平进样幅度:24mm

5.静音样品回缩:5-100pm

6.粗进速度:300pm/s，800pm/s和1800pm/s

7.废屑槽可拆卸

8.刀架带护手，确保操作者安全

9.具备刀架三点锁定及侧向移动功能，可充分利用刀片全长

10.手轮有独立的安全锁定系统

11.更换样本时样本夹无上下移动，保护样本和操作人员安全

12. 配有独立的控制面板和小手轮，既可以通过控制面板上的按键辅助修片，也可以通过小手轮辅助修片。